

## AY-HM01

### 厚膜银导体浆料

#### 产品介绍

AY-HM01 银导体浆料是一种基于银的低成本多层系统，AY-HM01银导体推荐作为氧化铝基板和杜邦介质的内导体，和杜邦 QM44 介质相兼容。

#### 产品特点

高导电性

在杜邦介质上具有优异的粘接性。

#### 典型性能

性能	指标
方阻 ( $m\ \Omega/sq$ )	1.1-1.9 @16 $\mu m$ 结厚度
可焊性 62Sn/36Pb/2Ag-220°C (氧化铝基板) %	95
分辨率 ( $\mu m$ , dried)	150/ 150
烧结膜厚 ( $\mu m$ )	9-12

#### 推荐工艺

**基板:** AY-HM01 性能是基于 96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

**印刷:** 推荐使用 325 目不锈钢丝网，乳胶厚度 15  $\mu m$ 。印刷速度可达 15 厘米/秒。印刷应该在清洁通风的环境中经行，在 20-23°C 环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

**干燥:** 浆料印刷后，在室温下流平 5-10 分钟，然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中 150°C 干燥 10-15 分钟。

**烧结:** 烧结在具有通气的链式烧结炉中进行，使用 60 分钟周期烧结曲线，峰值温度 850°C，10 分钟。

**存储和有效期:** 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存，温度小于 25°C。在 没有打开容器的情况下，保质期为发货日期 6 个月。长时间存放可能会发生固体物沉降，使用前进行充分搅拌。

**安全与处理:** 本产品含有有机溶剂和材料，在使用AY-HM01时应采取以下预防措施：

在有足够通风的情况下使用；

避免长时间接触皮肤避免长时间吸入蒸汽；

如接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗患处；

吞食有危险；